



株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2022年3月期第2四半期連結累計期間（2021年4月1日～2021年9月30日）の決算を公表しましたので、概要についてご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進み、経済活動の正常化が進みました。わが国経済も海外経済の回復に伴う輸出増加や政府による各種政策の実施等があり、緩やかながらも回復基調で推移しました。

当社が従事しておりますエレクトロニクス業界も、前連結会計年度の上期に自動車向けを中心に大幅な落ち込みとなりましたが、下期以降は幅広い分野において需要の回復が続きました。一方で、半導体供給不足や巣ごもり需要一巡といったリスク要因も顕在化しました。

このような中、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高は1,242億47百万円（前年同期比27.8%増）となりました。営業利益は増収効果や相対的に利益率の高い製品の販売に加え、円安寄与もあり、40億97百万円（前年同期比227.2%増）、

経常利益は40億59百万円（前年同期比142.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は29億9百万円（前年同期比95.9%増）となりました。

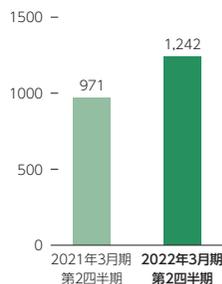
中間配当金につきましては、当第2四半期連結累計期間の業績等を勘案し、直近の配当予想の1株当たり30円から20円増配し、50円としました。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

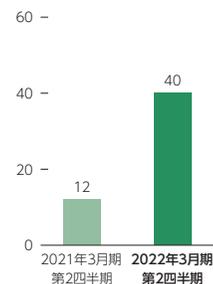
代表取締役 社長執行役員

稻宗 和彦

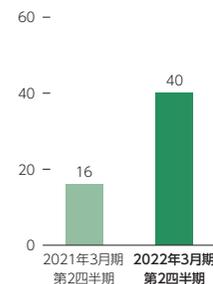
売上高 (億円)



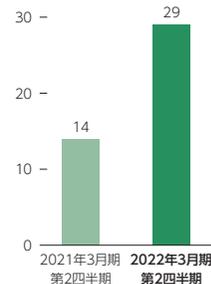
営業利益 (億円)



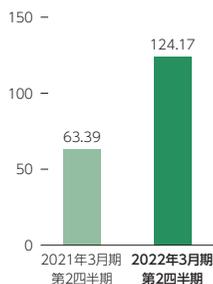
経常利益 (億円)



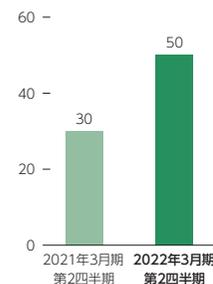
親会社株主に帰属する当期純利益 (億円)



1株当たり当期純利益 (円)



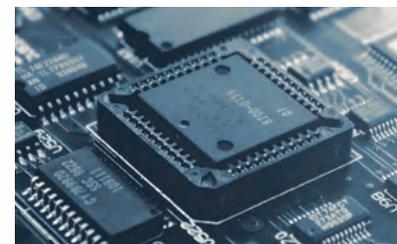
配当の状況 (円)



デバイス事業

売上高構成比 **88.2%**

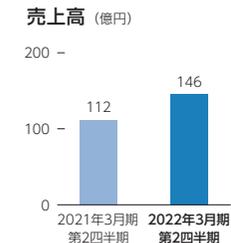
売上高は幅広い用途での需要回復を受け、前年同期比で販売数量が大幅に増加したことにより、1,096億17百万円（前年同期比27.5%増）、営業利益は、高利益率製品の販売等により34億63百万円（前年同期比172.1%増）となりました。



ソリューション事業

売上高構成比 **11.8%**

自動車向けビジネスを中心に前年同期比で販売が伸長した他、設備機器に係る大型案件が寄与したことにより、売上高は146億29百万円（前年同期比30.2%増）、営業利益は6億62百万円（前年同期比231.3%増）となりました。



新旧セグメントの対比表

2022年3月期より、報告セグメントを以下の通り変更しました。

旧セグメント		新セグメント	
半導体事業	メモリ・システムLSI・個別半導体	デバイス事業	半導体（メモリ・システムLSI・個別半導体）、電子部品（表示デバイス・機構部品）
電子部品事業	表示デバイス・電源・機構部品		
電子機器事業	システム機器・設備機器	ソリューション事業	システム機器*1、システムソリューション*2

*1 旧電子機器事業のシステム機器及び設備機器、並びに旧電子部品事業の電源を合わせています。
*2 従来はシステムソリューションに係る収益は各報告セグメントに含めていました。